



# 平成30年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成30年2月13日

上場会社名 株式会社 岡本工作機械製作所  
 コード番号 6125 URL <http://www.okamoto.co.jp>  
 代表者 (役職名) 取締役社長  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員 管理本部長  
 四半期報告書提出予定日 平成30年2月14日  
 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東

(氏名) 石井 常路  
 (氏名) 高橋 正弥

TEL 027-385-5800

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績(平成29年4月1日～平成29年12月31日)

### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
30年3月期第3四半期	20,440	23.8	1,146	128.6	943	343.9	771	384.3
29年3月期第3四半期	16,516	△9.8	501	△15.4	212	△49.1	159	△2.4

(注) 包括利益 30年3月期第3四半期 1,137百万円 (420.6%) 29年3月期第3四半期 218百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
30年3月期第3四半期	174.34	—
29年3月期第3四半期	35.98	—

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」を算定しております。

### (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
30年3月期第3四半期	29,776	10,333	34.7	2,336.42
29年3月期	28,273	9,470	33.5	2,139.79

(参考) 自己資本 30年3月期第3四半期 10,333百万円 29年3月期 9,470百万円

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり純資産」を算定しております。

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
29年3月期	—	0.00	—	4.00	4.00
30年3月期	—	2.00	—	—	—
30年3月期(予想)	—	—	—	30.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成30年3月期(予想)の1株当たり期末配当金については、当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し、年間配当金合計は「—」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期(予想)の1株当たり期末配当金は3円となり、1株当たり年間配当金は5円となります。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

## 3. 平成30年3月期の連結業績予想(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	28,000	17.9	1,600	40.4	1,350	75.7	1,100	90.5	248.55

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。平成30年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益については、当該株式併合の影響を考慮しております。詳細については、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

30年3月期3Q	4,717,895 株	29年3月期	4,717,895 株
30年3月期3Q	294,897 株	29年3月期	292,163 株
30年3月期3Q	4,424,802 株	29年3月期3Q	4,427,056 株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数(四半期累計)

(注) 当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

(株式併合後の配当及び連結業績予想について)

当社は、平成29年6月29日開催の第118期定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。なお、株式併合を考慮しない場合の平成30年3月期の配当予想及び連結業績予想は以下のとおりとなります。

1. 平成30年3月期の配当予想

1株当たり配当金 第2四半期末 2円00銭(注) 期末 3円00銭 年間配当金合計5円00銭

2. 平成30年3月期の連結業績予想

1株当たり当期純利益 通期 24円85銭

(注) 第2四半期末の配当は、株式併合実施前の株式数に対して支払いを行っております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(セグメント情報)	7
3. 補足情報	
受注及び販売の状況	8

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、先進国を中心に緩やかな景気回復基調が続きました。米国では個人消費や設備投資がやや鈍化したものの景気は安定しており、欧州でも地政学的リスクの顕在化懸念など、先行きに不透明感がありますが、雇用・所得環境の改善を背景に景気は緩やかな回復傾向で推移いたしました。アジアにおいては、中国では経済政策の効果もあり景気減速から安定化に向かい、その他の新興国も一定の成長を維持いたしました。

日本経済は、国内需要が持ち直しの動きをみせるなかで、個人消費に力強さは欠けるものの、輸出関連企業を中心に堅調に推移いたしました。

このような状況の中で当社グループは、中期経営計画「Mission GX 2019」の2年目として、海外販売拠点の増強やQCD改善活動によるコスト削減などを進め、グループの総合力を駆使して、業績向上に努めてまいりました。その結果、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は20,440百万円（前年同期比23.8%増）、営業利益は1,146百万円（前年同期比128.6%増）、経常利益は943百万円（前年同期比343.9%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は771百万円（前年同期比384.3%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### ①工作機械

国内市場におきましては、工作機械業界や半導体関連装置業界向けに大型研削盤や高精度タイプの研削盤、ロータリー研削盤などの需要が高まり、売上高は前年同期を上回りました。また受注につきましても、半導体関連装置部品や精密金型の業種等を中心に、前年同期を大きく上回る結果となりました。

海外市場におきましては、米国では航空機や自動車部品などを中心に、販売、受注共に堅調に推移いたしました。欧州では、需要は安定しており、フランス、イタリアなどで汎用タイプの研削盤の受注が増加したものの、不安定なロシア市況の影響を受け、売上高は前年同期を下回りました。アジアにおきまして、中国は精密金型や自動化設備などへの投資需要が旺盛で、拠点増強など営業強化策の効果もあり、販売、受注共に前年同期を上回りました。

以上の結果、売上高は16,436百万円（前年同期比15.1%増）、セグメント利益（営業利益）は890百万円（前年同期比0.3%増）となりました。

#### ②半導体関連装置

半導体市場におきましては、携帯情報端末の高機能化や世界的なEV（電気自動車）化へのシフトなどを背景に、拡大基調が継続いたしました。半導体関連装置の需要につきましても、ウェーハ、デバイス生産メーカーによる増産対応などの設備投資を中心に、国内外で好調に推移いたしました。

このような状況の中で当社グループは、ポリッシュ装置の重点販売、次世代パワー半導体用各種装置の拡販などの施策を進めてまいりました。その結果、中国及び東アジアにおいて、ウェーハ生産用のファイナルポリッシャーを中心に、素材加工用グラインダー、デバイス生産用バックグラインダーなどの販売、受注が高水準で推移いたしました。国内でも、ウェーハ生産用のファイナルポリッシャーをはじめ、材料メーカー向けにラップ盤やスライサーの売上が増加いたしました。受注につきましても、半導体需要の増加に伴って、ファイナルポリッシャーやグラインダーを受注するなど好調に推移いたしました。

以上の結果、売上高は4,003百万円（前年同期比79.2%増）、セグメント利益（営業利益）は897百万円（前年同期比326.5%増）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,502百万円増加し、29,776百万円となりました。主な要因は、たな卸資産が1,443百万円増加したことによるものであります。

当第3四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末と比較して638百万円増加し、19,442百万円となりました。主な要因は、長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む。）が1,448百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が1,135百万円、その他流動負債が1,081百万円増加したことによるものであります。

また、純資産は、前連結会計年度末と比較して863百万円増加し、10,333百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が505百万円、為替換算調整勘定が358百万円増加したことによるものであります。

これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の33.5%から34.7%となりました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績につきましては、平成29年5月15日に公表いたしました業績予想を変更しておりません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,699	3,564
受取手形及び売掛金	7,661	7,460
商品及び製品	1,720	2,058
仕掛品	2,364	3,279
原材料及び貯蔵品	2,387	2,578
その他	425	576
貸倒引当金	△25	△50
流動資産合計	18,233	19,466
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3,926	3,865
機械装置及び運搬具(純額)	2,291	2,233
その他(純額)	3,315	3,683
有形固定資産合計	9,533	9,782
無形固定資産	97	76
投資その他の資産		
投資有価証券	103	119
その他	376	366
貸倒引当金	△70	△35
投資その他の資産合計	409	450
固定資産合計	10,040	10,309
資産合計	28,273	29,776
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,523	3,659
短期借入金	7,327	7,388
1年内返済予定の長期借入金	2,075	1,644
未払法人税等	101	75
賞与引当金	263	121
製品保証引当金	39	42
その他	1,463	2,544
流動負債合計	13,793	15,475
固定負債		
長期借入金	3,541	2,524
退職給付に係る負債	493	416
資産除去債務	127	125
その他	846	900
固定負債合計	5,009	3,967
負債合計	18,803	19,442

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,880	4,880
利益剰余金	6,493	6,999
自己株式	△1,358	△1,366
株主資本合計	10,015	10,512
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	16	26
為替換算調整勘定	△698	△339
退職給付に係る調整累計額	136	133
その他の包括利益累計額合計	△544	△178
純資産合計	9,470	10,333
負債純資産合計	28,273	29,776

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)
売上高	16,516	20,440
売上原価	11,620	14,230
売上総利益	4,896	6,210
販売費及び一般管理費	4,395	5,064
営業利益	501	1,146
営業外収益		
受取利息	4	2
受取配当金	2	1
助成金収入	18	21
物品売却益	9	13
その他	33	23
営業外収益合計	67	63
営業外費用		
支払利息	203	193
為替差損	67	31
支払手数料	50	12
その他	34	28
営業外費用合計	355	265
経常利益	212	943
特別利益		
固定資産売却益	82	—
特別利益合計	82	—
税金等調整前四半期純利益	294	943
法人税等	135	172
四半期純利益	159	771
親会社株主に帰属する四半期純利益	159	771

(四半期連結包括利益計算書)  
(第3四半期連結累計期間)

(単位:百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
四半期純利益	159	771
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	19	10
為替換算調整勘定	40	358
退職給付に係る調整額	△0	△2
その他の包括利益合計	59	366
四半期包括利益	218	1,137
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	218	1,137



(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

I 前第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損 益計算書計上 額 (注)2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,282	2,233	16,516	—	16,516
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	14,282	2,233	16,516	—	16,516
セグメント利益	888	210	1,098	△597	501

(注) 1. セグメント利益の調整額△597百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成29年4月1日至平成29年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注)1	四半期連結損 益計算書計上 額 (注)2
	工作機械	半導体 関連装置	計		
売上高					
外部顧客への売上高	16,436	4,003	20,440	—	20,440
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	16,436	4,003	20,440	—	20,440
セグメント利益	890	897	1,788	△642	1,146

(注) 1. セグメント利益の調整額△642百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3. 補足情報

受注及び販売の状況

(1) 受注状況

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	20,990	137.7	9,363	176.5
半導体関連装置	9,970	344.3	7,808	577.2
合計	30,960	170.7	17,172	258.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同期比 (%)
工作機械	16,436	115.1
半導体関連装置	4,003	179.2
合計	20,440	123.8

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。